

	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	1	DIS-H-03768 (06159)	梅原		104.03.29	△					
△						△					
適用規格											
定格	使用温度範囲		-35℃~+85℃(注1)			保存温度範囲		-10℃~+60℃			
	電圧		AC 250V			適合コネクタ		DF1B-18S-2.5R			
	電流		AWG20~24: 3A AWG26: 2A AWG28: 1A AWG30: 0.5A								
性能											
	項目		試験方法			規格			QT	AT	
構造	外観、構造及び仕 上げ		目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○	
	表示		目視にて確認する。						○	○	
電気 的 性 能	低電圧、低電流下 の接触抵抗		100mA (DC又は1000 Hz) で測定する。			30 mΩ 以下			○	-	
	絶縁抵抗		DC 500 Vで測定する。			1000 MΩ 以上			○	-	
	耐電圧		AC 650 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	-	
機 械 的 性 能	繰り返し動作		30 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 30 mΩ 以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
	耐振性		周波数 10 ~ 55 Hz, 片振幅0.75mmで 3方向 各2時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 30 mΩ 以下 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃, 湿度 90~95% 中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗: 30 mΩ 以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 △ ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
	温度サイクル		温度 -55 → 5~35 → 85 → 5~35 ℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内 分 を 5 サイクル試験する。			① 接触抵抗: 30 mΩ 以下 ② 絶縁抵抗: 1000 MΩ 以上 ③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	-	
	はんだ耐熱性		【フゝ半田付けの場合】 はんだ温度 260 ℃, 5 秒間 で試験する。 【手半田付けの場合】 はんだこて温度 300℃, 3秒 で試験する。 但し、端子に力を加えないこと。			外観の変形及び端子などの著しい ガタがないこと。			○	-	
	はんだ付け性		はんだ温度 235 ℃, 浸漬時間 5 秒間 のはんだ付けを行う。			半田浸せき面の 95% 以上が新しい はんだでぬれていること。			○	-	
備考 (注1) 通電による温度上昇を含む。						製図	設計	検図	承認	出図	
						NC	NC	NC	NC		
						'03.04.02	'03.04.04	'03.04.23	'03.04.23		
試験規格の記載のない試験方法は JIS-C-5024を適用している。						松木	伝法谷	宮崎	宮崎		
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
			ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.			製品規格表			製品名 DF1BZ-18P-2.5DSA		
旧CL CL			図番 SLC4-301796-00			製品コード CL541-2015-5			1 1		